Hf02系強誘電体薄膜の抗電界の特異な膜厚依存性

Peculiar thickness dependence of coercive electric field in HfO2-based ferroelectric films 産総研¹, 東大工² ⁰右田 真司¹, 太田 裕之¹, 山田 浩之¹, 澤 彰仁¹, 鳥海 明²

AIST¹, Univ. of Tokyo², ^oS. Migita¹, H. Ota¹, H. Yamada¹, A. Sawa¹, A. Toriumi² E-mail: s-migita@aist.go.jp

【はじめに】 HfO2系強誘電体は 10 nm 以下の 薄膜でも明瞭な強誘電性が現れ、大きなバンド ギャップのおかげでリーク電流が小さい。構成 元素が high-k ゲートスタック技術の材料と同 じなので、BiやPbを用いるペロブスカイト系 強誘電体に比べてLSI製造技術との親和性に優 れている。HfO2系強誘電体はメモリを始めとす る様々な応用への期待が高まっている。

HfO2 系強誘電体の抗電界(E_C)はおよそ 1 MV/cm の大きさがあり、ペロブスカイト系強 誘電体と比べると非常に大きい。このことはメ モリ応用の際には有利であり、例えば10nmの 薄さでも2Vという大きなメモリウインドウを 確保できる。一方で分極反転を飽和させるため に必要な最大電界も強くなるため、薄膜が絶縁 破壊し易くなることに注意が必要である。

強誘電体の長年の研究では、膜厚が薄くなる ほど抗電界が大きくなることが知られており、 その関係は次の経験式で表される[1,2]

 $E_{\rm C} \sim d^{-2/3}$

こでdは膜の厚さである。本研究では、HfO2 系強誘電体薄膜の抗電界の膜厚依存性を調べ、 この経験式が成立するかを調べてみた。

(1)

【実験】Hf-Zr-O 薄膜と TaN 電極で構成される MIM キャパシタをスパッタ法で堆積して作成 した。Hf と Zr の組成は 50:50 である。高濃度 Si 基板上に TaN/Hf-Zr-O/TaN の順に積層膜を堆 積した後に真空中で 600℃, 1 min のアニールを 行った。さらにアルミ電極を堆積してからリソ グラフィーとドライエッチングでキャパシタ を加工した(サイズは 100 um x 100 um)。最後 に Si 基板の裏面にアルミ電極を形成した。

キャパシタの分極特性は TF Analyzer 2000E を用いて室温で測定した(1 kHz)。

【結果と考察】Hf-Zr-O の膜厚を変えた MIM キ ャパシタの P-V 特性を Fig. 1 に示す。6.8 nm から41 nmの厚さの膜いずれにおいてもヒステリ シスが現れており、強誘電体が生成していることが分かる。ただし厚膜では残留分極が小さく



Fig. 1 P-V characteristics of TaN/Hf-Zr-O/TaN capacitors prepared by annealing at 600°C.

なっており、これは強誘電相の体積分率が減少 しているためであると推察される。抗電圧は膜 厚とともに増加しているが、抗電界に換算する と 0.83~1.05 MV/cm となり、膜厚依存性は現 れなかった。

HfO2系強誘電体と PZT 系強誘電体の抗電界 の膜厚依存性を Fig. 2 にまとめた。我々のデ タは黒丸、他のグループのHfO2系のデータ[3-8] は白抜き、そして PZT についての報告例[2, 9-11]は赤丸で示す。PZT の場合には式(1)に則 った関係性が明瞭に現れている。そして PZT の極薄膜では抗電界は1 MV/cm レベルにまで 増加している。HfO2系だけ抗電界が特別に大き いわけではないことが分かる。一方で HfO2 系 はドーピング元素の種類や成膜法そしてプロ セス条件が異なる様々な報告を集めているが、 いずれも抗電界は1 MV/cm を超え膜厚依存性 は全く現れていない。HfO2系強誘電体は単一相 を得ることが困難であり、通常は常誘電相との 混合膜として生成する。HfO2系では強誘電相が 小さなグレインとして存在しているために抗 電界が大きく、そしてそれを取り囲む常誘電相 との比誘電率がほぼ同じであることから膜厚 を変えても抗電界が一定のように振る舞うの ではないかと推察される。

本研究はJST-CRESTの支援を受けて行われた。 参考文献

- [1] H. F. Kay and J. W. Dunn, Philos. Mag. 7, 2027 (1962).
- [2] C. Bjoermander et al., APL 66, 2493 (1995).
- [3] T. S. Boescke et al., APL 99, 102903 (2011).
- [4] J. Mueller et al., APL 99, 112901 (2011)
- 5] M. H. Park et al., APL 102, 202903 (2013)
- [6] S. Starschich et al., APL 102, 242905 (2013).
- [7] T. Mimura *et al.*, *APL* **109**, 052903 (2016). [8] L. Xu *et al.*, *APEX* **9**, 091501 (2016).
- [9] T. K. Kundu and J. Y. Lee, JJAP 39 3488 (2000).
- [10] N. A. Pertsev et al., APL 83, 3356 (2003).
- [11] Dahl et al., JAP **106**, 084104 (2009).



Fig. 2 Relationship between the coercive field and the thickness of ferroelectric films.